

锦州神工半导体股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

锦州神工半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）于2026年10月30日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议由公司董事长潘连胜先生召集并主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召集、召开方式符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经过与会董事认真审议，形成如下决议：

（一）审议通过《关于公司2026年第三季度报告的议案》

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《锦州神工半导体股份有限公司2026年第三季度报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

（二）审议通过《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》

董事会同意公司根据业务发展需要，拟在董事会作出决议之日起12个月内向银行申请不超过人民币8亿元的综合授信额度，该授信额度在授信期限内可循环使用，具体融资以实际发生为准。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的

《锦州神工半导体股份有限公司关于向金融机构申请综合授信额度的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

特此公告。

锦州神工半导体股份有限公司董事会

2026 年 10 月 31 日